

2010年5月11日
株式会社日立製作所

日立が革新的な設計スタイルを実現する 「LSI/プリント基板 設計ユーティリティサービス」を提供開始

ケイデンス社の協力のもと設計リソースを SaaS 型で提供し、ユーザーの需要に応える設計環境を実現

株式会社日立製作所(執行役社長:中西 宏明/以下、日立)は、米国ケイデンス・デザイン・システムズ社(社長兼 CEO:リップ・ブー・タン、以下、ケイデンス)の協力を得て、SaaS 型新サービス「LSI/プリント基板 設計ユーティリティサービス」を6月1日から提供します。本サービスは LSI^(*) やプリント基板の設計時、設計需要の変動に柔軟に対応できる設計環境を提供することによって、革新的な設計スタイルを実現するサービスです。

本サービスは、2010年1月28日に発表した「設計バリューチェーン改革サービス」を構成するサービスのひとつであり、日立のクラウドソリューション「Harmonious Cloud」における SaaS ラインアップのひとつとしても提供するものです。さらに、その他のサービスとの連携により、設計業務手順や設計開発体制の構築、改善を実施することで、設計品質の向上や設計期間短縮など、競争力強化のための設計の最適化と効率のいっそうの向上を図ることが可能となります。

本サービスでは、日立の Harmonious Cloud センタにおいて、まず、ケイデンスの SaaS 型 Hosted Design Solutions (HDS) をクラウド環境に対応させ、日立で実績のある設計環境運用技術と緊密に連携した顧客志向のターンキーサービスを提供します。これにより、ユーザーは設計状況に応じて大きく変動する設計環境への需要に対し、必要とされる量の計算機資源とツール群からなる設計リソースを柔軟に利用することができます。また、クラウド環境に適した最先端ハードウェアと EDA^(**) ツールの組み合わせによる新しいライセンス形態も検討します。

本サービスを利用することで、設計リソース不足による品質低下や開発遅延などに起因する事業機会の損失を防止するだけでなく、時間的、リソース的制約のもとで実施せざるを得なかった従来の設計スタイルを変革し、より高度な機能の追加や、高い品質の作り込みなど、革新的な設計の推進を可能とします。

特に、競争力強化のために、ピーク需要に確実に対応できる設計リソースを必要としている企業や、設計リソースのオフバランス化を考える企業にとって、本サービスは高い投資効果を持つ適切かつ高効率な設計環境を提供することができます。

*1 LSI: Large Scale Integration

*2 EDA: Electronic Design Automation

日立は、2005年度から、自社および自社グループ内の半導体設計環境をクラウド環境で統合し、設計業務手順や設計環境を共通設計基盤として、標準化・最適化・高効率化し、技術とノウハウの

蓄積を図ってきました。本サービスは、この共通設計基盤の機能と環境をサービス化し、広く社外のユーザーに提供していくものです。

本サービスの特徴

1. 高性能なハードウェア環境

LSI 設計を高効率で実行するためには、常に最先端かつ最高性能の計算機と大容量のメモリが必要となります。本サービスは、このような設計特有の要件をクラウド環境で実現します。ユーザーは、ピーク需要や突発的需要の発生時に本サービスを活用することによって、設計リソース不足による設計品質の低下や開発遅延などを回避でき、結果的に事業機会の損失を防止することができるとともに、さらに意欲的な設計も可能となります。

また、本サービスは、環境に配慮し、耐震・免震構造、完全二重化電源など、大規模災害にも耐えうる構造を持つ日立の Harmonious Cloud センタを使用しており、ユーザーの貴重な設計資産を安全に守るとともに、グリーン IT 推進にも貢献します。

2. クラウド環境に対応した柔軟な EDA ツールのライセンス形態

実際の設計に必要なとなるツールの種類や本数は、設計段階や設計状況に応じて変化します。本サービスでは、変動する設計需要に応じて、設計リソースを柔軟に提供する環境を提供します。また、ケイデンス社が得意とする複数 CPU を活用した並列処理環境を最大限に利用することにより、設計期間の短縮を図ることが可能となります。

3. 顧客志向のターンキーサービス

本サービスでは、単に設計環境を提供するだけでなく、ユーザーそれぞれの状況に対応した設計環境構築、運用・保守、バックアップ、設計リソース最適化、利用状況可視化・分析・予測、利用上限値設定、超過アラートなど、様々な付帯サービスを提供します。これにより、ユーザーは安心して設計リソースを使用できるとともに、複雑なキュー制御、ジョブ管理、プロジェクト課金管理、ライセンス管理など、設計特有の運用の手間を回避、軽減することができます。

価格と提供時期

サービス	価格	提供時期
LSI / プリント基板 設計ユーティリティサービス	個別見積	2010 年 6 月 1 日

日立のクラウドソリューション「Harmonious Cloud」に関するホームページ

<http://www.hitachi.co.jp/cloud/>

関連情報

<http://www.hitachi.co.jp/Div/mdd/solution/valuechain.html>

展示会への出展予定について

本サービスは、2010年5月12日(水)～14日(金)に東京ビッグサイトにて開催される「第1回 クラウドコンピューティング EXPO」(<http://www.cloud-japan.jp/>)の日立ブースにおいて、紹介される予定です。<http://www.hitachi.co.jp/cloudexpo/>

本件についてのお問い合わせ先

株式会社日立製作所 情報・通信システム社 マイクロデバイス事業部 営業本部 [担当:伊藤]

〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号

電話:03-4232-5200(ダイヤルイン)

以上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
